

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260723

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称 及人员姓名	2026 年 7 月 23 日下午 14:00~16:00：嘉实新加坡：陈颖灵、孙悦，风和亚洲：Aobo，润晖投资：潘岨，Keystone Investors: Roger，思睿集团：Gillbert，龙石资本：Zhang Ke、陆杨，砺思资本：Shengyu，Amber Capital：Jack，宁远资本：Mark，信为资管：Jacob，涌容（香港）资产：Sam，Optimas Capital Management：Nicole，壹拾资产：罗鹏巍，混沌天成国际资产：周高鼎，Auspice Asset Management：Wang 等，共 24 名投资者及证券人员
时间	2026 年 7 月 23 日下午 14:00~16:00
地点	公司 9 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	2026 年 7 月 23 日下午 14:00~16:00：董秘杨平彩女士、董事长助理兼投关总监熊亚威先生
投资者 关系活动 主要内容 介绍	公司介绍： 鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨半导体材料板块、锂电材料板块和打印复印关键材料板块等。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头，占据 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务，新近切入新能源锂电关键功能材料领域，推动公司高速可持续发展。 问 1：先进封装带动玻璃基板产业发展，公司如何看待玻璃基板 CMP 抛光垫市场机遇？同时本次筹划 H 股上市对于公司全球化布局有哪些支撑作用？ 答：近年来先进封装产业快速发展，CMP 抛光材料是支撑玻璃基板实现规模化量产的关键配套材料。相较于硅片加工，玻璃基板加工形态由圆形转为方形，同时玻璃材料脆性远高于硅片，对 CMP 加工工艺形成新挑战，

	相应对 CMP 抛光材料性能提出更高标准。为持续巩固公司在 CMP 抛光垫领域的市场竞争优势、丰富完善产品矩阵，公司计划于潜江园区投资建设第三条软抛光垫生产线，产品重点聚焦玻璃基板 CMP 抛光垫、直径 2 米以上大尺寸抛光垫两大高端方向，紧抓下游产业发展机遇。 海外市场方面，公司 CMP 抛光垫海外业务稳步推进，目前已和多家海外客户达成合作意向，产品导入工作有序开展。公司本次筹划 H 股发行并于香港联合交易所主板上市，将助力公司深化创新材料领域全球化战略布局，加快海外业务拓展节奏，持续提升品牌国际影响力与整体综合竞争实力。 问 2：公司抛光液、光刻胶相关产品性能进展及客户验证情况如何？ 答：公司控股子公司鼎泽新材料专注半导体 CMP 抛光液研发及产业化，铜及铜阻挡层抛光液、氧化铝体系抛光液、碳化硅衬底抛光液等核心产品实现自主配方、研磨粒子原料自主配套，持续对标海外主流抛光液产品开展全方位性能迭代验证。其中铜阻挡层抛光液已取得多家头部晶圆厂批量订单，碳化硅衬底抛光液实现批量供货；相关抛光液产品在头部晶圆制造产线通过长期量产验证，抛光速率、表面缺陷、平坦度等关键指标满足客户工艺要求，顺利导入量产供应链，可实现对海外同类耗材的有效替代。依托全链条自主研发优势，公司持续拓展头部存储、逻辑晶圆厂客户，抛光液产品亦荣获头部晶圆厂优秀供应商奖项，产品综合竞争力得到市场充分认可。 光刻胶方面，公司依托潜江年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶全流程自主量产产线，对标海外同类产品完成技术攻关与工艺适配，国产化推进成效显著。公司已实现光刻胶核心树脂、光致产酸剂等关键原材料自主合成，打通“有机合成—高分子合成—精制纯化—光刻胶混配”完整生产链条，产品配方、工艺体系具备完全自主知识产权，产品性能对标海外主流光刻胶型号。目前公司累计布局 40 余款高端晶圆光刻胶，近 30 款产品同步推进客户验证，共 8 款 ArF、KrF 光刻胶实现稳定批量供货，多款新品有望于年内实现订单转化，覆盖多类细分制程应用需求。同时公司同步布局 BARC、SOC 等光刻配套材料，构建光刻胶一体化供应体系，不断增强国产光刻材料综合配套能力。 未来公司将持续加大抛光液、光刻胶两大产品线研发投入，不断优化迭代产品性能，积极开拓海内外优质客户，助力国内半导体材料产业高质量发展。 问 3：请问公司光刻胶二期产线投产是为下游客户扩产做准备吗？ 答：公司本次光刻胶产能扩建，是基于全球半导体行业发展态势，结合国内晶圆制造企业中长期扩产规划，针对存储芯片、先进逻辑、先进封装三大高景气下游赛道开展的前瞻性产能布局，核心目的为匹配下游客户产能扩张及高端材料增量需求。公司潜江二期年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶项目，为国内首条实现“有机合成—高分子合成—精制纯化—光刻胶混配”全流程自主制备的高端光刻胶量产产线。项目可自主量产核心树脂、光致产酸剂等关键原材料，有效保障产品供应链自主制备，同时形成良好的成本优势，产品可适配全制程工艺，广泛应用于高端存储芯片、先进逻辑芯片制造领域。
--	--

目前，公司高端光刻胶产品已与多家国内头部晶圆厂开展多品类、多批次送样验证，部分产品型号已实现批量供货，产品性能与稳定性获得下游客户充分认可。本次产能扩建将精准对接下游存储、逻辑晶圆厂商的高端光刻胶采购及使用需求，加速公司高端晶圆光刻胶产品的产业化、规模化落地，进一步夯实公司半导体材料平台化布局，持续提升核心市场竞争力。

问 4：公司收购皓飞新材切入新能源锂电材料领域，目前整合情况及业务情况如何，未来规划是怎样的？

答：公司收购皓飞新材布局新能源锂电材料赛道，是立足自身新材料产业深耕优势，依托长期积累的研发创新、规模化生产、供应链统筹及产业化运营能力，推进公司新材料业务多元化、立体化发展的重要战略举措。现阶段，标的公司整合融合与业务拓展工作均按既定战略规划稳步落地，整体运营进展符合公司预期。整合运营方面，公司持续对皓飞新材开展系统化赋能整合，稳步优化其组织架构、完善内控管理体系，统筹双方生产运营、供应链及市场资源。凭借公司在精细化工、高端新材料研发、标准化量产管控、客户服务运维等领域的成熟经验，助力皓飞新材完成锂电功能材料技术升级、产能优化与品质体系升级，打通研发、生产、市场全链条协同渠道，实现管理模式、核心技术、产业资源的深度融合。同时，依托公司标准化合规治理体系规范标的公司日常经营，保障其经营体系高效、稳定运转，为后续业务放量增长夯实运营基础。业务落地方面，皓飞新材聚焦高端锂电功能材料核心赛道，持续深耕新能源电池下游市场，全力推进客户资质认证、产品工艺适配及商业化导入工作。凭借自身在锂电材料领域的技术储备与行业客户资源，有序开展产品送样测试、工艺验证及订单对接工作，持续开拓优质新能源终端客户，产能释放与市场拓展工作稳步推进。目前，新能源锂电材料业务已成为公司新材料板块全新的核心增长业态。

未来发展方面，公司将坚守半导体材料核心主业，以本次产业并购为重要契机，深度整合双方技术、人才、渠道及产能核心资源，持续加码锂电新材料领域研发投入，推动产品工艺迭代、技术升级及新品研发落地，持续丰富完善锂电材料产品矩阵。同时，依托公司成熟的产业化落地体系与资本市场平台优势，持续开拓下游优质新能源客户，稳步落地产能建设规划，持续提升细分市场占有量。公司将充分发挥半导体材料、显示材料、新能源材料多赛道协同发展优势，搭建高附加值、多元化的新材料产业布局，持续提升公司整体盈利水平与长期成长潜力，全力打造国内极具竞争力的综合性新材料平台企业。

问 5：未来几年，公司在半导体材料核心赛道的业绩增长驱动因素主要是什么？

答：未来数年，公司半导体材料将依托产品矩阵完善、产能有序释放、技术壁垒加固及行业国产化进程提速等多重利好，实现业绩持续稳健增长，核心增长动力主要来源于四大方面：

第一，CMP 全链条材料协同放量，构筑基本盘增长主力。公司已形成抛光垫、抛光液、清洗液一体化产品布局，各品类产品深度绑定国内头部存

	储、逻辑晶圆厂商。伴随下游晶圆厂持续扩产、整体稼动率维持高位，公司产品覆盖制程持续拓宽，客户采购份额稳步提升。同时海内外市场拓展节奏加快，存量客户份额提升叠加海外新增订单落地，将持续带动 CMP 材料板块营收稳步增长，成为公司半导体材料核心基本盘。第二，前瞻性产能布局落地，充分承接下游增量需求。公司精准把握半导体产业发展节奏与下游市场需求，提前布局 CMP 抛光材料、高端晶圆光刻胶、半导体显示材料及各类配套材料规模化产能。一方面持续优化现有产线工艺、提质增效，提升产能利用率与产品良率；另一方面新建项目按计划稳步落地投产，充足、配套的产能储备可高效承接下游持续增长的市场需求，保障客户订单快速落地转化，为业绩增长提供坚实产能支撑。第三，技术平台协同优势凸显，持续强化产品核心竞争力。公司长期深耕半导体新材料领域，在核心配方、高纯纯化、全制程工艺适配等方面积累深厚技术壁垒，多品类产品技术可互通复用、迭代升级。依托公司一体化研发平台、完善的供应链体系及标准化品质管控体系，实现研发、生产、质控、服务全链条协同，持续优化产品性能、提升产品稳定性与综合竞争力，稳步抬高板块整体盈利水平。第四，行业国产化进程加速，带动客户渗透率持续提升。当前国内晶圆制造领域需求持续释放，公司凭借本土化快速响应能力、全周期配套技术服务以及批次性能稳定的产品优势，持续深化与头部晶圆制造企业的合作，不断提升核心产品在主流客户中的渗透率。同时公司持续优化半导体材料业务结构，聚焦高附加值高端产品，推动整体经营质量与业绩规模持续上行，助力公司半导体材料业务长期高质量发展。
附件清单	无
日期	2026 年 7 月 23 日